

Sheet No.1/2

製品規格／Product Specification 品種名／Type Number ： 2 S C 3 7 0 4 松下統一品番／Matsushita Unified Parts Number ： 2 S C 3 7 0 4 0 0 L 1)					Prepared by E.SUZUKI	Checked by T.KUBO	Applied by S.NAKAGAWA	Established by				
種別／Type	シリコントランジスタ／Silicon Transistor											
用途／Application	UHF帯低雑音増幅用／UHF Low-noise Amplifier											
構造／Structure	NPNエピタキシャルプレーナ形／NPN Epitaxial Planar Type											
外形／Outline	Mini3-G1					マーク記号／Marking		2W				
絶対最大定格／ Absolute Maximum Ratings	VCBO 15 (V)	VCEO 10 (V)	VEBO 2 (V)	IC 80 (mA)	Pc 200 (mW)	Tj 150 (℃)	Tstg -55 ～ +150 (℃)					
電気的特性／Electrical characteristics (Ta = 25 ℃ ± 3 ℃)												
項目／Item		記号／ Symbol	測定条件／Measuring condition	typ.	Limit		Unit					
					min.	max.						
コレクタ・ベース遮断電流 Collector-Base Cutoff Current		ICBO	VCB=15 V, IE=0			1	μA					
エミッタ・ベース遮断電流 Emitter-Base Voltage		IEBO	VEB=1 V, IC=0			1	μA					
直流電流増幅率 Forward current transfer ratio		hFE1	VCE=8 V, IC=20 mA		50	300	-					
直流電流増幅率 Forward current transfer ratio		hFE2	VCE=1 V, IC=3 mA		80	280	-					
コレクタ容量 Collector Output Capacitance		Cob	VCB=10 V, IE=0, f=1 MHz	0.7		1.2	pF					
トランジション周波数 Transition Frequency		fT	VCE=8 V, IC=20 mA, f=0.8 GHz	6			GHz					
順方向伝達利得 Forward Transfer Gain		S21e ²	VCE=8 V, IC=20 mA, f=0.8 GHz	13			dB					
電力利得 Power Gain		GUM	VCE=8 V, IC=20 mA, f=0.8 GHz	14			dB					
雑音指数 Noise Figure		NF	VCE=8 V, IC=7 mA, f=0.8 GHz	1.0		1.7	dB					
Note: 測定方法は、日本工業規格 JIS C 7030 トランジスタ測定方法による。 Measuring methods are based on JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD JIS C 7030 Measuring methods for transistors. 1) 包装／Packing <table><tr><td>Code</td><td>包装形態／Packing form</td></tr><tr><td>L</td><td>エンボスTXタイプ／embossed TX type</td></tr></table>									Code	包装形態／Packing form	L	エンボスTXタイプ／embossed TX type
Code	包装形態／Packing form											
L	エンボスTXタイプ／embossed TX type											
2005.05.31												
Established		Revised										

製品規格／Product Specification

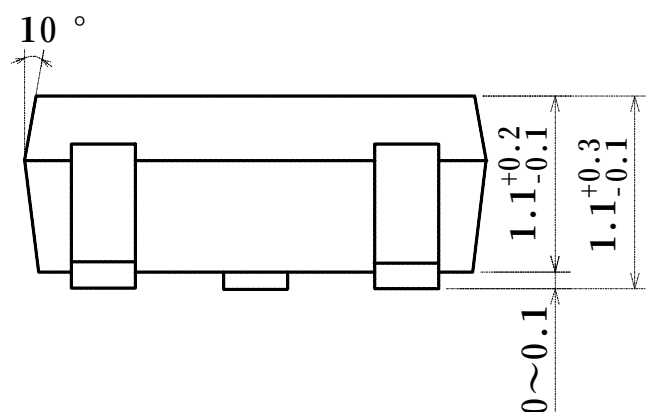
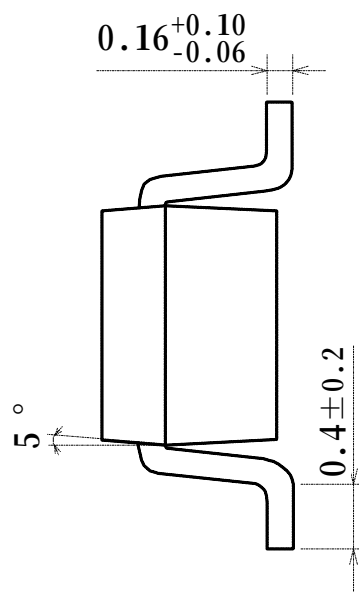
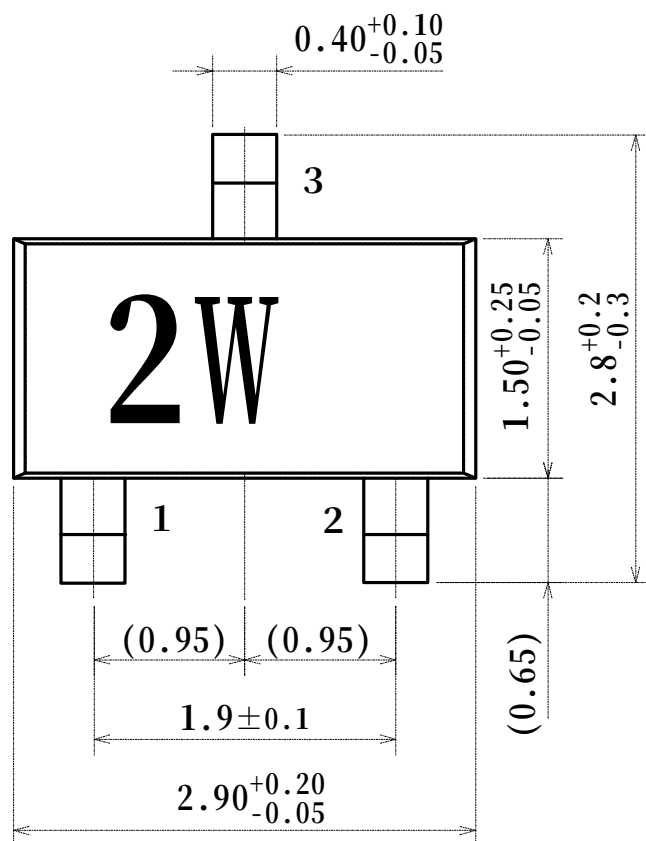
外形図／Outline : Mini3-G1

品種名／Type Number : 2 S C 3 7 0 4

: 2 S C 3 7 0 4 0 0 L

1)

単位／Unit:mm



注) 品名略号のみ表示

Display at trademark

1. B a s e

2. E m i t t e r

3. C o l l e c t o r

項目／Item	内容／Contents
リード材質／Lead Material	Cu合金／Cu Alloy
リード処理／Lead Process	はんだ(Sn-2Bi)めっき／Solder(Sn-2Bi) plating
モールド材質／Mold Material	エポキシ樹脂／Epoxy

2005.05.31

Established

Revised